

アプライド・マテリアルズ (AMAT)

増収・過去最高益なるも成長は鈍化。欧米における半導体製造国内回帰への対応とパッケージング技術開発が今後のテーマ。

ナスダック | オンライン市場 | 業績フォロー

BLOOMBERG AMAT:US | REUTERS AMAT.OQ

直近業績：11/16 発表の23年10月期の第4四半期単体業績は、売上高が前年同期比で横ばいの67.2億USD、営業利益が同1%減の19.7億USD、最終利益が同26%増の20億USDとなった。通期では売上高が265.1億USD、営業利益が同2%減の76.5億USD、純利益が同5%増の68.5億USDと過去最高益を更新。売上や営利が鈍化する中で最高益更新は、米金利上昇や株高を背景とした保有有価証券の含み益などによるものである。地域別売上では欧米が好調、アジア太平洋地域は縮小、セグメント別では半導体システムに属するファウンドリ向け売上が拡大するも、フラッシュメモリが縮小。アプライドグローバルサービス (AGS) が堅調な一方で、ディスプレイ関連は縮小。

事業展開・戦略：半導体微細化の鈍化対策として注目を浴びる複数のチップのパッケージング技術であるHI(ヘテロジニアスインテグレーション)に用途に向けた、成膜やボンディング、エッチングといったパッケージング工程に関する製造装置・ソリューションを複数展開。半導体製造における人工知能活用を強化した製造プラットフォーム Vistara™ を発表 (7月11日)。12月12日、HIにおける3次元パッケージングに向けたデジタルリソグラフィ技術 (DLT) システムにおいてウシオ電機 (6925) と共同開発を発表。今後需要が見込まれるAI向けの高度な計算能力の半導体製造への製品・ソリューションを揃えていく構えである。

投資論点・リスク：配当は毎年増加傾向にある一方で、配当性向は低下傾向にある。自社株買いの総額は業績に連動して上下するため、半導体市場の調整期の終了までは22年のような総還元額の増額は期待できないだろう。

地域別売上における米国・欧州の増加は半導体製造の国内回帰を反映しているものとみえる。TSMCのアリゾナ工場における労働組合との合意および協定の締結 (23年12月) により建設効率化の見通しがたったことや、独ドレスデンにおける工場建設は同社のAGS部門や半導体システム部門の収益への追い風となるだろう。一方で、2020年以降売上の20~40%を占める中国は、米政府による先端技術の対中輸出規制により今後縮小が見込まれる。

当社とTSMCとの関係は根強く、TSMCが選出する優秀サプライヤーに毎年選出されている。TSMCとの関係強化を継続する一方で、AI用推論チップでゲームチェンジャーを狙うインテルとの関係強化も今後必要となるだろう。

四半期業績 (10月期)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24(F)
売上高 (百万USD)	6,739	6,630	6,425	6,723	6,468
当期利益 (百万USD)	1,717	1,575	1,560	2,004	1,667
希薄化後EPS (USD)	2.02	1.86	1.85	2.38	1.92
四半期配当 (USD)	0.26	0.32	0.32	0.32	0.32

通期実績推移 (10月期)	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24(F)
売上高 (百万USD)	17,202	23,063	25,785	26,517	26,110
売上総利益 (百万USD)	7,692	10,914	11,993	12,384	12,241
粗利率 (%)	44.72	47.32	46.51	46.70	46.88
営業利益 (百万USD)	4,365	6,889	7,788	7,654	7,272
営業利益率 (%)	25.38	29.87	30.20	28.86	27.85
当期利益 (百万USD)	3,619	5,888	6,525	6,856	6,398
希薄化後EPS (USD)	3.92	6.40	7.44	8.11	7.71

引用：企業公表値、ブルームバーグ (Fはブルームバーグ予想値および会社予想に基づく)

フィリップ証券株式会社・リサーチ部

三角友幸

TEL：+81 3 3666 0707 (直通)

E-mail：tomoyuki.misumi@phillip.co.jp

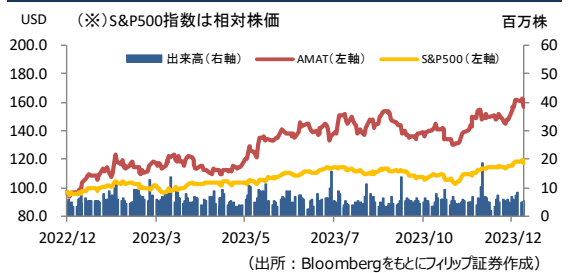
予想配当 (USD)	1.27
株価 (USD)	162.33
実績 PER (倍)	20.02
予想 PER (倍)	20.74
時価総額 (10億 USD)	134.9
企業価値 (10億 USD)	133.9
3か月平均売買代金 (百万USD)	816.8

* 配当予想と予想PERはブルームバーグ、各数値は12/19日終値による

会社概要

米カリフォルニアを本拠地とする世界最大級の半導体製造装置・ディスプレイ製造装置メーカー。1967年創業、1972年にNASDAQ上場。主要セグメントは半導体製造における前工程・後工程における製造装置を提供する①『半導体システム』、半導体製造における工場配置や製造プロセスなどのコンサルティングを行う②『アプライド・グローバル・サービス (AGS)』、OLEDなどの先端ディスプレイ製造装置を提供する③『ディスプレイ関連市場』。現CEOはゲイリー・E・ディッカーソン氏。

株価推移



①地域別売上推移	FY21	FY22	FY23	CAGR
米国	2,038	3,104	4,006	40%
ヨーロッパ	1,097	1,674	2,152	40%
日本	1,962	2,012	2,075	3%
韓国	5,012	4,395	4,609	-4%
台湾	4,742	6,262	5,670	9%
東南アジア	677	1,084	758	6%
中国	7,535	7,254	7,247	-2%
アジア太平洋地域売上比率	86.4%	81.5%	76.8%	--

*CAGRは21年を基準年とした23年までの平均複利成長率

②セグメント別売上推移	FY21	FY22	FY23	CAGR
半導体システム	16,286	18,797	19,698	10%
ファウンドリ・ロジック	9,804	12,406	15,167	24%
DRAM	3,042	3,571	3,349	5%
フラッシュメモリ	3,440	2,820	1,182	-41%
アプライドグローバルサービス	5,013	5,543	5,732	7%
ディスプレイ関連市場	1,634	1,331	868	-27%

*CAGRは21年を基準年とした23年までの平均複利成長率

③株主還元推移	FY20	FY21	FY22	FY23
自社株買い (百万USD)	649	3,750	6,104	2,189
配当総額 (百万USD)	787	838	873	975
DPS (USD)	0.87	0.94	1.02	1.22
配当性向 (%)	22.2	14.7	13.7	14.3

④売上・上位顧客	FY21	FY22	FY23	CAGR
サムスン電子	4,612	3,094	3,977	-5%
TSMC	3,459	5,157	5,038	13%
インテル	--	2,579	--	--

*CAGRは21年を基準年とした23年までの平均複利成長率

*企業公表された売上比率を用いてアナリストにより算出

*21年と23年のインテルは10%を下回ったため、詳細の記載なし

⑤株主構成 (5%超保有)	
VANGUARD GROUP	8.8%
ブラックロック	8.7%
CAPITAL GROUP COMPANIES INC	7.04%

引用元：図表①~④は企業公表値、図表⑤はブルームバーグデータに基づく。

【レポートにおける免責・注意事項】

本レポートの発行元: フィリップ証券株式会社 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町4番2号

TEL: 03-3666-2101 URL: <http://www.phillip.co.jp/>

本レポートの作成者: フィリップ証券 リサーチ部 三角 友幸

当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。フィリップ証券は、レポートを提供している証券会社との契約に基づき対価を得る場合があります。当資料に記載されている内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利はフィリップ証券株式会社に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。

<日本証券業協会自主規制規則「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則 平14.1.25」に基づく告知事項>

・本レポートの作成者であるアナリストと対象会社との間に重大な利益相反関係はありません。